2025年度事業計画書

自：2025年4月1日 至：2026年3月31日

1. 学会運営

(1) 学会運営基本方針

以下の運営基本方針を今年度も継続していきます。

1. 世界をリードする実装技術のけん引役としての活動
2. 幅広い技術領域をカバーしている強みを活かした展開
3. 将来を担う若手実装技術者の育成と、魅力ある活動の場の提供

今年度も、現地開催とオンラインのそれぞれの利点を活かしたハイブリッド形式を基本として、MES2025、第40回春季講演大会、公開研究会、教育事業事業を実施します。

ハイブリッド開催により参加の選択肢が広がることで、各イベントへの参加がしやすくなり、より多くの方々への情報発信が可能となることから、学会活動の一層の活性化が期待されます。

また実装をとりまく環境においては、日本の半導体後工程（いわゆる「バックエンドプロセス」：組立・パッケージング・テスト等）が、近年の半導体産業の再興と戦略的再編の中で大きな注目を集めております。この機会を捉え、学会としても最新情報を正確かつ迅速に、会員および一般の方々へ発信できるよう取り組んでまいります。

更に、教育の分野においては、次代を担う若手技術者へ実装技術を継承するため、実装基礎講座の継続的な開催を実施してまいります。

今後も、人と人の直接的なつながりの場を提供するとともに、オンラインの活用により、より多くの方々へ最新情報を届けられるような活動を積極的に展開していきます。

(2) 総務委員会

学会運営の持続可能性を確保するために、さまざまな改革を実施してきております。事務局員のスキル向上はもちろん、デジタル環境の導入も実施してきており、今後更にAIを活用し事務効率の向上を図っていききたい。

(3) 財務委員会

今年度の予算については、昨年度から推移を基に好調な予算を作成している。現在世界で起こっている不確実な状況が、どのような形で影響するかを良く見極めながら、各イベントの参加費等について検討を実施していく必要がある。

(4) 広報委員会

学会からの情報発信を、公共向け、会員向けを更に強化していく。他学会との連携も視野に入れ、より多くの社会の認知度向上及び会員への情報サービス向上を図り、会員増強、イベント集客に繋げていく。また、海外向けホームページが完成したことにより、新たに海外からの各社イベントへの参加、論文投稿の増加を積極的な展開を行う。学会の国際的知名度向上のために国際事業委員会と連携し学会の国際的な知名度向上を推進する。

(5) 会員増強委員会

大会事業、展示会運営委員会、技術調査事業、教育事業、支部事業の各イベント開催を通じ会員増強活動を実施する。新規入会優遇キャンペーンを継続しより多くの会員獲得を目指していく、特に学生会員、若手会員の勧誘に力を注いでいきたい。

【第3号議案】

(6) ミッションフェロー活動

ミッションフェローとして独自にイベント開催を若手中心に実施してきた。新たなメンバーを加え、学会活性化、会員増強に向けた新規企画を継続的に実施していく。

(7) JPCAとの連携

JPCAとJIEPは極めて重要なパートナーである。JPCA Showを起点に定期的な情報共有を行いお互いの強みを活かし発展、成長させる。更に、JPCA会員に向け学会会員価格を設定し学会で実施している教育事業、公開研究会等の積極的な参加を促すことを継続する。

2. 大会事業活動（定款第4条第1号関係）

春季講演大会、秋季大会マイクロエレクトロニクスシンポジウム（MES）、国際会議 ICEP、ワークショップを実施します。これらのイベントへの参加者および発表者の増加を図るため、各行事を現地参加とオンライン参加を組み合わせたハイブリット型で実施していく。また、各大会の連携を強め、継続的な情報提供を強化し、更に新分野のセッションの企画などを強化していく。また、各大会の継続的な実施を図るためのステアリング委員会を整備していく。

(1) 「国際会議 ICEP-IAAC2025」

2025年4月15日～19日に現地（長野県若里文化交流センター）で開催する。2023年から参加者の増加傾向が強まる中、世界から多くの参加をいただき実装技術の最新情報を発信していきたい。今大会は、昨年を超える参加者が期待でき、多くの研究者、聴講者が参加することを見込んでおり、各方面での意見交換ができると期待している。

(2) 「第34回マイクロエレクトロニクスシンポジウム2025」

2025年9月3日～5日 大阪大学中の島センター（大阪市）現地会場とオンライン配信とのハイブリットでの開催を実施する。口頭発と昨年新説したポスターセッションを加え、実装分野の企業・大学・公共研究機関の最新の研究・開発の成果発表と情報交換の場を提供していく。スマートプロセス学会との連携、特別講演の企画、各種のオーガナイズドセッションなどを充実し、多くの参加を期待している。

(3) 2025ワークショップ

湘南WSは2025年10月20日～21日に、これまで修善寺で開催してきたWSを湘南（葉山）の地へ変更することで、新たなWSの形を形成していく事を計画している。都心から近いという利点を生かし多くの参加者を集めて、実装技術、関連技術について、発表者と参加者と双方向のディスカッションにより理解を深めることができるイベントとして提供する。

(4) 「第40回春季講演大会」

2026年3月10日～12日東京たま未来メッセ（八王子）で現地とオンライン配信のハイブリッド開催を予定している。今回初めて大学以外の会場にて開催することになり、今後継続的に同じ場所を活用できるかの試験的開催にもなる。会場の展示機能を十分に生かし、新たなイベントを企画していきたい。また、これまで通り、実装分野の企業・大学・公共研究機関の新技术開発の発表と情報交換の場として提供することはもとより、特別講演、企業展示によるものづくり技術の紹介、チュートリアルセッションにより若手研究者の参加者増も図り、より多くの方に参加いただき実装技術情報共有の場を提供する。

3. 展示会運営委員会活動（定款第4条第1号関係）

JPCA Show と同時開催するマイクロエレクトロニクスショーの展示企画として、最先端実装技術シンポジウム、アカデミックプラザ、及び、eX-tech を6月4日～6月6日 東京ビッグサイト東館で実施する。eX-tech、アカデミックプラザのブース展示についても同時開催する。

【第3号議案】

SEMICON JAPAN 2025 12月17日～19日東京ビッグサイト への展示を予定。3Dチップレット研究会ブースは会場正面付近を予約済み、広く学会活動のアピールを予定している。

4. 技術調査事業活動（定款第4条第2号関係）

技術委員会および研究会は、学会の基盤活動を担っており、その活動を強化し活性化させることを目指し、前年に引き続き、技術委員会と研究会の活動について学会内外に発信し研究会同士の連携を促進し、学会外や学会以外との交流を通じて活動を活性化させることを目指しています。半導体産業、光電融合技術など世界のテクノロジーは急速に進化している。このような変化の速い時代において、新たな知識や技術を積極的に取り入れ、時代の変化に適応することが成功の鍵となる。その為に、各委員会研究会同士の連携を深め、更には、統廃合を含め継続的な活動を担える委員会をめざしていく。また、具体的な活動は、対面活動とオンライン活用の両方の利点を最大限に活かし、最新情報の意見交換、最新情報を発信できる環境を整備し、拡充させていくことを目指す。

(1) 技術委員会の活動

11の技術委員会を組織、実装技術分野の技術動向を調査しそれらの成果をまとめて学会誌特集号に掲載する。また、大会事業や展示会事業に委員を派遣し、各イベントの企画運営を支援します。さらに、教育事業委員会と連携し、実装教育の充実にも協力していく。

(2) 研究会の活動

現在の19研究会では、エレクトロニクス実装技術領域の環境変化に対応しつつ活動を展開する。基礎要素から応用までの幅広い実装関連テーマについて、委員同士が技術情報を交換し、情報共有の場を提供する。

(3) 技術調査事業活動成果の普及

技術委員会および研究会の活動で得られた成果を公開研究会や学会誌等で広く公開していく。

(4) 情報提供方法について

これまでの現地参加型の公開研究会とオンライン配信を組み合わせたハイブリッドの実施を推進する。同じ場所に集まり情報交換の形式とともに、遠隔地からも参加しやすい環境を整備することにより、様々な情報が場所を問わず共有できる方法を充実させる。

5. 教育事業活動（定款第4条第3号関係）

将来を担う実装技術者、若手技術者を育成するために極めて重要であり、学会の果たすべき重要な役割である。

(1) 教育講座

「PWB製造初級講座」と各種実装教育講座を実施し、実装分野の研究開発者の育成に寄与します。また、技術運営委員会の協力を得ながら「実装技術総合基礎講座」をリニューアルし、講座の立ち上げを実現する。

(2) 教育セミナー

公開研究会では、取り上げにくいテーマで、実装関連のセミナーを平易に解説する「実装セミナー」と、実装だけではなく、実装環境を取り巻く様々な問題を解説するセミナーも実施を検討する。

(3) 実習付き教育講座

実習付き教育講座については、演習時間を充実確保するなどカリキュラムを工夫して、継続実施する。また、テーマについても、「伝熱解析の基礎と演習」「AI2oT講座の開設（電子工学的AI実装）」の2講座を予定している。

(4) エレクトロニクス実装基礎講座

【第3号議案】

エレクトロニクス実装技術の総合講座として、今年度もオンデマンド方式で実施していきたい。若手研究者、学生に対し実装全般の知識を広める活動として中核の教育事業とっていく。

6. 会誌発行委員会活動（定款第4条第4号関係）

学会活動のアウトプットとして重要であり、例年通り学会誌を7回、英文論文誌を1回発行する。今年度は、前年度に実施した論文の早期公開と電子化を継続的に実施する。また、会員アンケートを実施することで会員の要望や希望を把握し実現に向けて検討する。英文論文誌は、海外への情報発信を強化するため電子閲覧での一般公開を継続、英文誌発行に先立って論文ごとに準備が整いしだい公開し査読完了から公開までの期間を短縮することを図る。

(1) エレクトロニクス実装学会誌の発行

例年通り、機関誌「エレクトロニクス実装学会誌」を7回発行する。研究開発活動の成果として研究論文、総合論文、速報論文、解説等を掲載し実装技術に関する最新情報を会員に提供する。学会主催の大会行事で発表した論文に対し積極的に学会誌への掲載を勧誘する等、論文数の減少に歯止めを掛ける。また、理事会はじめ学会活動状況についても情報発信をしていく。

(2) 英文論文誌の発行

本学会の国際的な認知とプレゼンスの向上を図るため引き続き英文論文誌(Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging Vol.18-19)を発行する。電子閲覧を基本とし、学会ホームページ及びJ-STAGE(科学技術振興機構の総合電子ジャーナルプラットフォーム)から一般閲覧できるようにし、海外への情報発信を活性化していく。さらに、英文ホームページより広く論文投稿を実施できる環境を整備していく。

(3) 日経テクノロジーオンラインへの抜粋版掲載

日経テクノロジーオンラインへの抜粋版掲載を継続する。海外への情報発信と技術普及を促進する。

(4) 収支改善

会誌発行事業の収支改善に向けた対策も急務である。電子化により広告等の掲載が減少しているため他の方法で広告を取り込む検討を行い新たな収入源を確保していく。

7. 国際事業活動（定款第4条第5号関係）

国際会議 ICEP を機軸に、IEEE EPS Japan Chapter, IMAPS との連携を継続する。また、パンパシフィック SMTA との情報交換も行い、日本で開催される国際学会との連携も含めて、関係強化を図っていく。これまで同様、IAAC(IMAPS All Asia Conference)を通じて、台湾、韓国との関係強化を進める。さらに、ASEAN 地域における学会活動拡大を念頭に、日系法人を中心にセミナー協力、技術情報提供など会員獲得を始める。

(1) 国際会議 ICEP-IAAC2025

IEEE EPS Japan Chapter、IMAPS、IMPACT との連携、IEEE EPS Japan Chapter、IMAPS と、MOU 締結の手続きを行う。

(2) 国際事業体制

ICEP 開催に関して、ICEP Steering Committee を開催し数年先を見据えた体制を構築する。また、他の日本で開催される国際学会との連携も含め新たな仕組を構築する。

(3) ASEAN 地域における学会活動展開

ベトナムなど ASEAN 地域における学会活動拡大を図る。英文ホームページにより今後日系法人を中心に会員獲得を進めるとともに、セミナー協力、技術情報提供など現地活動への協力を行う。

8. 支部事業活動（定款第4条第6号関係）

支部の主体性を尊重しつつ活動を推進していく。関西支部、九州支部、北海道・東北支部も以下の独自イベントを実施していく。また他機関との共催で企画し支部会員の情報交流の場を提供するとともに産業界・大学と連携する活動を行う。

(1) 関西支部の活動計画

実装フェスタ関西 2025（2025年7月3日4日開催）、若手研究会セミナー（開催日未定）、技術講演会（開催日未定）、ぷらっと関西（開催日未定）のイベントを実施します。実装フェスタ関西 2025は、現地での開催のみで行い、この機会に経験豊かな先輩と対面してナイトセッションなどを企画し、多くの方々が情報共有できる場を提供していく。

(2) 九州支部の活動計画

九州支部の独自イベントとして、講演会などを他機関との共催で企画し、支部会員の情報交流の場を提供するとともに産業界・大学と連携する活動を展開していく。

(3) 北海道・東北支部の活動計画

北海道・東北地区の会員増強のために、北海道東北地区でセミナー、見学会を企画していく。また、宮城県との共催セミナーについても連携し積極的に学会のPR活動等を行う。

9. 表彰委員会活動（定款第4条第6号関係）

学会活動の活性化と研究開発者のモチベーションの向上のため、例年通り、エレクトロニクス実装に関する学術の発展および学会活動に対して功績のあった方に学会賞、功績賞、技術賞、論文賞、功労賞、およびマイスター賞を贈呈する。ICEP、大会事業、秋季大会 MES、春季講演大会についても、例年通り優秀発表者を表彰する。